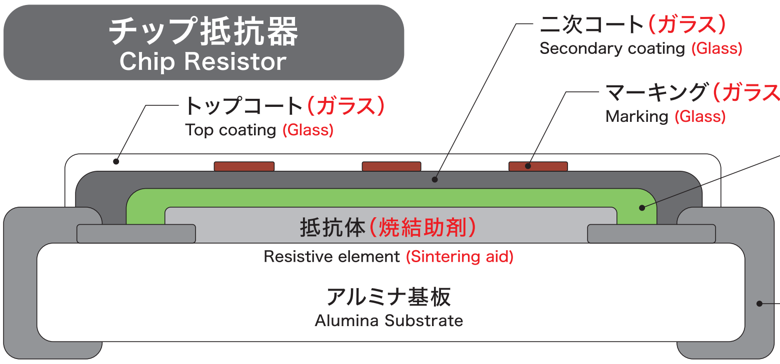
電子デバイス用ガラス製品

Lead-free glass powder for electronic components

チップ抵抗器
Chip Resistor



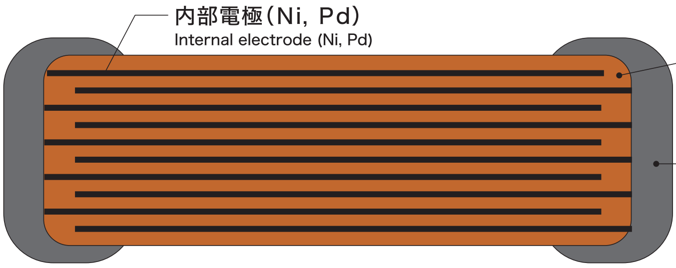
一次コート(ガラス)
Primary coating (Glass)

- 耐めっき性 Plating resistance
- 抵抗体との相性 Compatibility with resistive elements

Ag電極(焼結助剤)
Silver electrode (Sintering aid)

- 耐めっき性 Plating resistance
- 銀、素地との密着性 Adhesion to silver and substrate

積層セラミックコンデンサ
Multilayer Ceramic Capacitors



チタン酸バリウム(焼結助剤)
Barium titanate (sintering aid)

- 焼結性 Sinterability

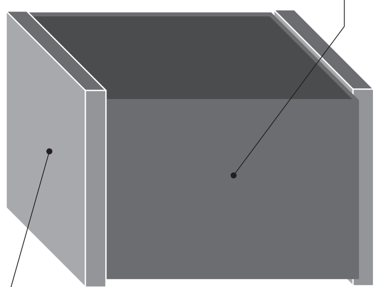
外部電極(Cu, Ag)(焼結助剤)
External electrode (Cu, Ag) (sintering aid)

- 耐めっき性 Plating resistance
- 銀、素地との密着性 Adhesion to silver and substrate

チップサーミスタ, インダクタ など
Chip thermistor, inductors and others

オーバーコート(ガラス)
Overcoating (Glass)

- 耐めっき性 Plating resistance
- 絶縁性, 耐湿性 Insulation and moisture resistance



外部電極(Cu, Ag)(焼結助剤)
External electrode (Cu, Ag) (sintering aid)

- 耐めっき性 Plating resistance
- 銀、素地との密着性 Adhesion to silver and substrate

タイプ Main element	製品名 Product	熱膨張係数 ($\times10^{-7}$/℃) Coefficient of thermal linear expansion	軟化温度 (℃) Temperature of softening	絶縁抵抗値 (Ω) Insulation resistance value
Bi	GF3410	108	414	5.0×10^{9}
	GF3520	77	518	1.4×10^{13}
	GF3550	84	560	6.4×10^{8}
	GF3580	68	578	7.1×10^{12}
Zn	GF4550	80	575	7.7×10^{9}
	GF4610	60	630	4.8×10^{11}
	GF4630	43	631	2.0×10^{12}
Si	GF5600	75	600	9.4×10^{9}
	GF5770	64	740	2.8×10^{11}
	GF5780	56	780	1.9×10^{12}